[19]中华人民共和国专利局

[11] 公开号 CN 1108026A

5/ 10 (2)



[12] 发明专利申请公开说明书

[21]申请号 94113752.X

143公开日 1995年9月6日

[51]Int.Cl⁶ H05K 3/46

[22]申请日 94.9.20

[30]优先权

[32]93.9.21 [33]JP[31]234519 / 93 [32]93.9.29 [33]JP[31]242450 / 93

[71]申请人 松下电器产业株式会社

地址 日本大阪府

[72]发明人 中谷迪一 鲁山秋仁 川北晃司 十河宽 小川立夫 小岛环生

Correspond to Japanese application number H6-211074 which priority app. numbers are above 234519/93 142450/93

[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 代理人 王忠忠 萧掬昌

H05K 3/42

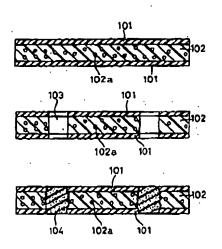
说明书页数:

附图页数:

[54]发明名称 电路基板连接件及用其制造多层电路基 板的方法

[57]摘要

电路基板连接件包括在两面设置无粘性薄膜的有机多孔基材及在所需位置设置的通孔, 其以导电树脂料填充直至无粘性薄膜的表面。此结构能使内通路孔连接, 因而可获得电路板速接件, 及高载性高质量的电连接件。由于采用包括在两面设有无粘性薄膜的有机多孔基板及在所需位置设置了通孔, 其以导电树脂料填充至无粘性薄膜表面的电路板连接件, 可以用相当稳定地制造的双面板或四层板容易形成高多层板。



(BJ)第 1456 号